

第126回マイクロ接合研究委員会  
プログラム

日 時： 2019年 7月 19日(金) 10:30～16:40

場 所： (株)島津製作所 東京支社 2階 イベントホール

時 間	題 目	講 演 者
司 会 福本信次 (大阪大学)		
10:30～11:15	『ナノ粒状負極の不均化反応を利用した LiB 電池特性の向上』 (資料番号MJ-767-2019)	東京大学 大学院工学系研究科 ○神原淳
11:15～12:00	『金属箔プレス品の 多層積層低温拡散接合による金属 MEMS の製造』 (資料番号MJ-768-2019)	(株)小松精機工作所 ○白鳥智美
12:00～13:20	昼 食 休 憩	
13:20～13:30	委 員 会 議 事	
司 会 松坂壮太 (千葉大学)		
13:30～14:15	『3D プリンターでバイオリン、その設計と製作』 (資料番号MJ-769-2019)	地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター ○横山幸雄
14:15～15:00	『AFM でみる界面の測定事例』 (資料番号MJ-770-2019)	(株)島津テクニサーチ ○小暮亮雅 (株)島津製作所 北村孝平
15:00～15:10	休 憩	
司 会 小山真司 (群馬大学)		
15:10～15:55	『高温動作パワーモジュールの はんだ接合部におけるパワーサイクル信頼性』 (資料番号MJ-771-2019)	(株)日立製作所 ○宮崎高彰、池田靖 (株)日立パワーデバイス 串間宇幸、川瀬大助
15:55～16:40	『接合後熱処理が Ag ナノ粒子焼結接合層に及ぼす影響』 (資料番号MJ-772-2019)	東海大学 工学部材料科学科 ○宮沢靖幸、工藤勝裕 日産自動車(株) 岩田昌也 (株)アイメタルテクノロジー 小原永成

※プログラムは都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。